



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110325001

2011 年 3 月 28 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

ASP TMS320C6410/TMS320C6413/TMS320C6418 製品 前処理サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、**変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。**変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日以降**に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	ASP TMS320C6410/TMS320C6413/TMS320C6418製品 前処理サイト追加 現行 : TI-DMOS5 (Dallas, 米国) 変更後 : TI-DMOS5 (Dallas, 米国), TI-DMOS6 (Dallas, 米国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	7月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルは5月上旬の出荷より予定しています。)			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容 : 弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) TMS320C6410/TMS320C6413/TMS320C6418製品のC035. Aプロセス前処理サイトについて、現行 TI-DMOS5 (Dallas, 米国) サイトにて製造いたしておりますが、供給能力向上の為に、これに加えて、TI-DMOS6 (Dallas, 米国) サイトでの製造を追加し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理サイト	TI-DMOS5 (Dallas, 米国)	TI-DMOS5 (Dallas, 米国) TI-DMOS6 (Dallas, 米国)

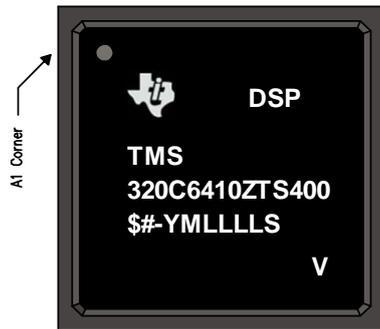
理由 : 供給能力向上の為

対象製品リスト

対象製品名			
TMS320C6410GTS400	TMS320C6413GTS500	TMS320C6413ZTSA500	TMS320C6418ZTS600
TMS320C6410ZTS400	TMS320C6413GTS500	TMS320C6418GTS600	TMS320C6418ZTSA500
TMS320C6410ZTSA400	TMS320C6413ZTS500	TMS320C6418GTS500	

製品表示

この変更に伴い、製品捺印は下記の様になります。前処理サイトコードは捺印上に明示されます。



- YM = Year/Month
- LLLL = Lot Trace Code
- S = Assembly Site Code
- \$ = Wafer Fab Site Code
 - C: TI-DMOS5
 - \$4: TI-DMOS6
- V = used for TI internal purposes and may change value or length or may not be included without notification
- o = Pin 1

図1 製品捺印の例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010年9月3日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	DM642 ZNZ Package		DM642 ZDK Package	
Wafer Fab:	DM6		DM6	
Wafer Technology:	1233C035.A6		1233C035.A6	
Assembly Site:	PHI		PHI	
Package/Code/Pins:	FCBGA/ZNZ/548		FCBGA/ZDK/548	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Temp Cycle	-40/125C, 1000cyc		240/0	
**Storage Bake	150C, 1000 Hours		240/0	
**Temp Humidity Bias	85C/85%RH, Vmax, 1000 Hours (ZDK)		239/0	
	85C/85%RH, Vmax, 1000 Hours (ZNZ)		72/0	
**Unbiased HAST	110C/85%RH, 264 Hours		246/0	
High Temp Op Life	105C, 1000 Hours		418/0	
ESD HBM	2.0kV		9/0	
ESD CDM	500V		9/0	
CMOS Latch-up	100mA & 1.5*Vmax, 90C		6/0	
Manufacturability	per mfg. site specification		Approved	
Notes:				
** Itest requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-4/260C				
ZDK/ZNZ qual data has been utilized for ZTS/GTS packages qual				
23x23mm FCBGA = ZDK package designator (0.5mm ball diameter)				
23x23mm FCBGA = ZTS package designator (0.6mm ball diameter)				
23x23mm FCBGA= GTS package designator (0.6mm ball diameter)				
27x27mm FCBGA= ZNZ package designator (0.6mm ball diameter)				
For THB tests, original PCN plan was for 231 units of ZNZ package. TI modified the qual plan to substitute 239 units of ZDK package plus 72 units of ZNZ package.				